

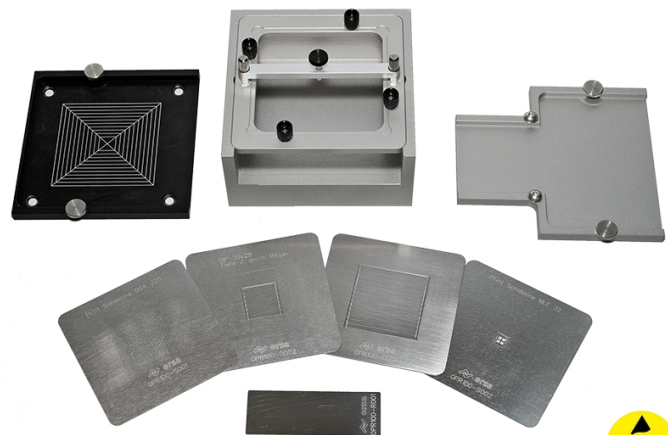
Estación DIP&PRINT



La estación **Dip&Print** de ERSA permite al usuario de los equipos de rework de ERSA realizar de forma sencilla, fiable y repetitiva el trabajo de preparación del componente para su soldadura (aplicación de flux o pasta de estaño)

El **dispositivo para stencil** (opcional) permite, utilizando parámetros definidos, **sumergir componentes en flux o pasta de soldadura**, creando un depósito específico para las conexiones que se deben soldar.

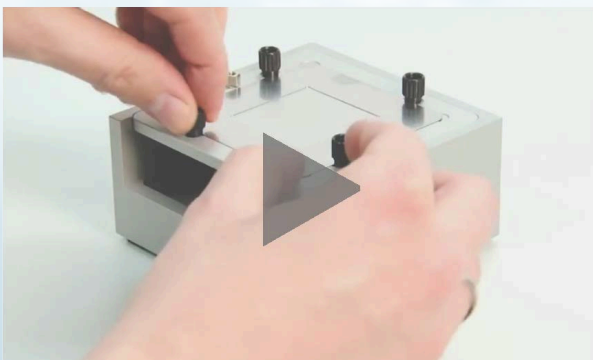
Este método es ideal para **aplicaciones con BGAs y la mayoría de componentes "fine pitch"**. Por ejemplo, utilizando un componente para stencil específico, la pasta de soldadura depositada en las conexiones QFN/MLF y en cualquier otro componente SMD se puede añadir de forma sencilla y precisa.



En el proceso de impresión, la pasta de soldadura se aplica desde la parte inferior del componente, durante el tiempo que este este en el stencil, desde donde se retira y se coloca en la posición final mediante la **unidad de posicionado**.

Existe un **set de fijación** para poder colocar esta estación DIP&Print en la unidad de posicionado de los equipos de rework de ERSA.

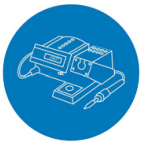
Vídeos



Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Opciones disponibles

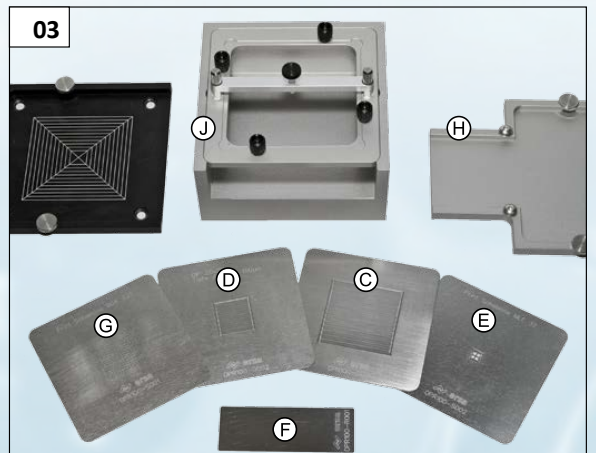
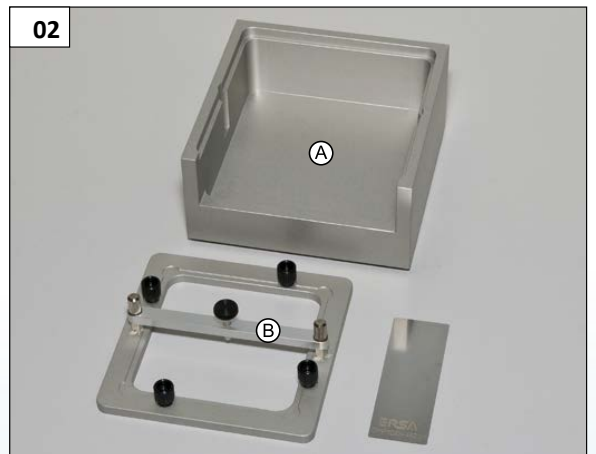
| Código | Descripción |
|-----------------|-------------------------|
| ER-OPR100 | Estación Dip&Print |
| ER-OPR100-PL550 | Rack de fijación PL 550 |
| ER-OPR100-PL650 | Rack de fijación PL 650 |



Accesorios

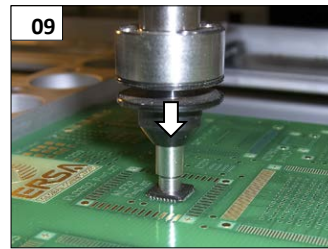
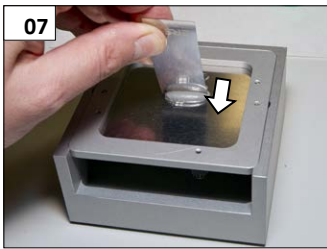
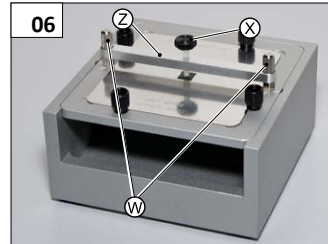
| | Código | Descripción |
|---|--------------|--|
| A | | Base de la estación |
| B | ER-OPR100-20 | Marco Dip&Print |
| C | OPR100-D001 | Dip stencil 300 µm, componente max. 40 x 40 mm |
| D | OPR100-D002 | Dip stencil 150µm, componente max. 20 x 20 mm |
| E | OPR100-S002 | Print stencil para MLF 32 |
| F | OPR100-R001 | Enjugador de goma 70 mm x 25 mm |
| G | OPR100-S001 | Print stencil para BGA 225 |
| H | OPR100-PL550 | Rack de fijación PL550 |
| J | OPR100-PL650 | Rack de fijación PL650 |
| | OPR100-S003 | Print stencil para QFN 20 |
| | OPR100-D001 | Dip stencil 40 x 40 mm/0,30 mm |
| | OPR100-D002 | Dip stencil 20 x 20 mm/0,15 mm |
| | OPR100-D003 | Dip stencil 20 x 20 mm/0,10 mm |
| | OPR100-D004 | Dip stencil 40 x 40 mm/0,10 mm |
| | OPR100-D005 | Dip stencil 40 x 40 mm/0,15 mm |
| | OPR100-D006 | Dip stencil 50 x 50 mm/0,30 mm |
| | OPR100-D007 | Dip stencil 50 x 50 mm/0,20 mm |
| | OPR100-D008 | Dip stencil 20 x 20 mm/0,05 mm |
| | OPR100-D009 | Dip stencil 20 x 20 mm/0,20 mm |
| | OPR100-D010 | Dip stencil 40 x 40 mm/0,20 mm |
| | OPR100-D011 | Dip stencil 40 x 40 mm/0,25 mm |

Nota: stencils adicionales por encargo. Por favor, facilitar dimensiones y el tipo de componente.





Impresión selectiva de pasta de soldadura en un componente para rework



4. Componente (G), cut-out (H) para el componente en el print stencil.

5. Inserte el print stencil con el cut-out (H) boca arriba en el marco del stencil (B) y fíjelo con los tornillos.

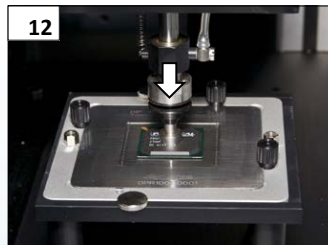
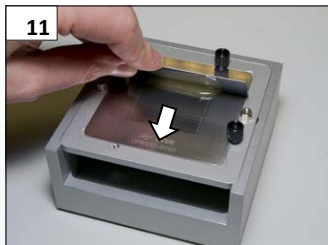
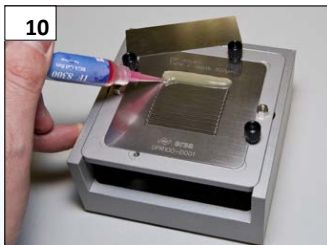
6. Coloque el componente en el Cut-out (H) del print stencil. Fije el dispositivo de sujeción (Z) con los tornillos de mariposa (W) casi sin tensión al print stencil.

7. Dele la vuelta al marco del stencil (B). Aplique pasta de soldadura usando el enjugador de goma (F)

8. Retire el marco del stencil (B) de la base (A). Inserte el marco del estencil con el componente boca arriba en el rack de fijación (opcional) del PL550 o PL 650 y fíjelo. Abra el tornillo de sujeción (X) y afloje el dispositivo de sujeción (Z) en el marco del stencil (B).

9. Levante el componente con el cabezal de colocación y colóquelo en la PCB utilizando la fuerza de presión más baja posible.

Sumergiendo componentes en flux o pasta de soldadura



10. Inserte el dip stencil en el marco del stencil (B) y fíjelo como se muestra en la figura 5. Aplique flux o pasta de soldadura en uno de los lados del cut-out.

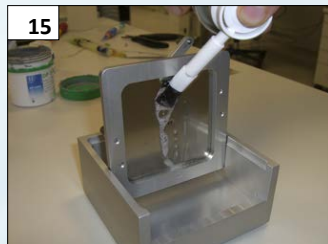
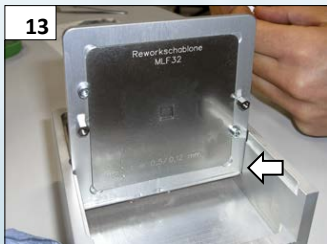
11. Esparza el flux o la pasta de soldadura usando el enjugador de goma. Asegúrese de que el enjugador de goma no se dobla durante el proceso.

12. Retire el marco del stencil (B) de la base (A). Inserte el marco del stencil con el cut-out boca arriba en el rack de fijación (opcional) del PL550 o PL 650 y fíjelo. Sumerja el componente en flux o pasta de soldadura con el sistema de colocación.

13. Retire el flux o la pasta de soldadura sobrante manualmente lo mejor que pueda antes de la limpieza. Luego, inserte verticalmente el marco del stencil (B) en las dos ranuras de la base (A)

14. Aplique removedor de flux o un limpiador similar para retirar el resto del flux, pasta de soldadura. Asegúrese de que el stencil está realmente limpio.

Posibilidad de limpieza integrada para la plantilla después del uso



Después de la limpieza, los residuos del limpiador en la base se pueden retirar con una toallita absorbente.